

股票简称：容大感光

股票代码：300576

**深圳市容大感光科技股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行
股票预案**



二〇二四年六月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。

重要提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行的最终发行对象将根据年度股东大会授权，由董事会及其授权人士按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与主承销商遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

3、本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	高端感光线路干膜光刻胶建设项目	17,591.65	12,373.00
2	IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目	10,179.75	9,695.00
3	补充流动资金	2,432.00	2,432.00
合计		30,203.40	24,500.00

注：募投建设项目预备费和铺底流动资金由公司自有资金或通过其他融资方式解决，不涉及本次募集资金。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序

予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

4、本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

5、本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，由公司 2023 年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产 20%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行数量上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

6、本次以简易程序向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

7、本次发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次发行股票完成后的新老股东共享。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，

公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。有关公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、未分配利润使用安排情况，参见“第四节 公司利润分配政策及执行情况”，并提请广大投资者关注。

8、本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形发生。

9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况参见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”。公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

10、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”，注意投资风险。

目 录

发行人声明	1
重要提示	1
目 录	4
释义	6
第一节 本次发行股票方案概要	9
一、发行人基本情况.....	9
二、本次发行的背景和目的.....	9
三、发行对象及其与公司的关系.....	15
四、本次发行方案概要.....	16
五、本次发行是否构成关联交易.....	19
六、本次发行不会导致公司控制权发生变化.....	19
七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件.....	19
八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	19
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	21
一、本次募集资金使用计划.....	21
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析.....	21
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	33
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况.....	33
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	34
三、公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	35
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....	35
五、本次发行对公司负债情况的影响.....	35
六、本次股票发行相关的风险说明.....	35
第四节 公司利润分配政策及执行情况	39
一、公司现行利润分配政策.....	39
二、公司最近三年利润分配情况.....	41

三、发行人最近三年未分配利润使用情况.....	43
四、未来三年股东回报规划.....	43
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	47
一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...	47
二、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体的承诺.....	47

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人/容大感光/公司/本公司	指	深圳市容大感光科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行股票、	指	深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的行为
本预案	指	深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
珠海容大	指	珠海市容大感光科技有限公司，公司全资子公司
光刻胶	指	又称光刻材料，由树脂、感光剂和溶剂三种主要成份组成的对光敏感的混合液体，主要用于电子信息产业中印制电路板的线路加工、各类显示面板的制作、半导体芯片及期间的微型图形加工等领域
PCB	指	Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板、印刷电路板，重要的电子部件之一，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体
半导体	指	Semiconductor，常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
阻焊油墨	指	PCB 感光阻焊油墨，用于涂覆在印制电路板表面形成有选择性的、永久性的聚合物保护层的油墨，PCB 光刻胶的一种
湿膜	指	PCB 感光线路油墨，以光成像原理将电子线路图形转移至 PCB 板上的制作 PCB 电路图形的油墨，PCB 光刻胶的一种
感光线路干膜	指	用光固化方式进行印刷电路板图形转移的薄膜材料，干膜光刻胶的一种
阻焊干膜		固化后作为永久阻焊层，起保护线路的作用，干膜光刻胶的一种，主要应用于 HDI 板、IC 载板等领域
一般商用感光线路干膜	指	适用于分辨率在 50 μm 以上的线路干膜光刻胶，主要用于车载电源板、电脑主机板、家电线路板等领域
高端感光线路干膜	指	适用于分辨率达 25 μm 以下的线路干膜光刻胶，主要用于 HDI 板、半导体显示用面板、半导体引线框架、IC 载板等领域
LDI	指	Laser Direct Imaging，激光直接成像技术
电子化学品	指	电子工业使用的专用化工材料，即电子元器件、印制线路板、工业及消费类整机生产用的各种化学品及材料，又称电子化工材料
g 线光刻胶	指	主要用于 435nm 光刻工艺中的光刻胶
i 线光刻胶	指	主要用于 365nm 光刻工艺中的光刻胶
KrF 光刻胶	指	主要用于 248nm 光刻工艺中的光刻胶

ArF 光刻胶	指	主要用于 193nm 光刻工艺中的光刻胶
EUV 光刻胶	指	主要用于 7nm 或更小逻辑制程节点的关键制造工序中的光刻胶
物联网、IoT	指	Internet of Things, 互联网基础上的延伸和扩展的网络, 将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络, 实现在任何时间、任何地点, 人、机、物的互联互通
树脂	指	高分子化合物, 是由低分子原料通过化学反应形成的大分子的产物
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International, 国际半导体产业协会的简称, 致力于促进微电子、平面显示器及太阳能光电等产业供应链的整体发展
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics, 世界半导体贸易统计协会的简称, 半导体产品公司作为会员组成的非盈利组织
公司章程	指	深圳市容大感光科技股份有限公司章程
董事会	指	深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳市容大感光科技股份有限公司股东大会
监事会	指	深圳市容大感光科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
最近三年	指	2021 年、2022 年、2023 年
报告期/报告期内	指	2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-3 月
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外, 指人民币元、人民币万元、人民币亿元

特别说明:

1、本预案部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异, 均因计算过程中的四舍五入所形成。

2、本预案中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计, 包括本公司的市场份额等信息, 来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上

述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。

3、如无特殊说明，本预案中的财务数据为合并报表数据。

第一节 本次发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称	深圳市容大感光科技股份有限公司		
英文名称	Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd.		
成立日期	1996 年 6 月 25 日		
上市日期	2016 年 12 月 20 日		
注册资本	295,708,699 元		
法定代表人	黄勇		
股票上市地	深圳证券交易所		
股票简称	容大感光	股票代码	300576
注册地址	广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）		
办公地址	广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）		
邮编	518103	电子邮箱	samcai@sزد.com
电话	0755-27312760	传真	0755-27312759
经营范围	一般经营项目是：印制线路板专用油墨、光刻材料及其配套化学品的研发，精细化工产品的购销；从事货物及技术进出口业务（以上均不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及化学试剂，不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：普通货运。		

二、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

公司本次募集资金投资项目中，高端感光线路干膜光刻胶建设项目和 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目是响应国家电子产品产业链自主可控的迫切需求，结合公司在感光化学品行业多年的技术积累，为优化公司产品结构和满足下游客户日益提升的产品需求而作出的重要布局。

1、光刻胶行业利好政策频出为行业营造良好的环境

光刻胶是光刻工艺中的关键材料，当前被广泛应用于半导体、平板显示、PCB 等关乎国民经济、工业发展的关键领域。21 世纪以来，全球 PCB、显示、半导体产能逐渐向亚洲尤其是中国大陆转移，带动上游产业链国内需求的快速增长，

行业呈明显的进口替代趋势。为了推动光刻胶终端应用行业的转型升级，促进中国国民经济的发展，国家逐步出台政策，大力支持光刻胶行业的发展。与光刻胶行业相关政策如下：

发布时间	发布单位	政策名称	核心内容
2023.12	发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	明确半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料列为鼓励类发展的项目。
2023.12	工信部	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》	将“通用型半高感 LDI 光致抗蚀干膜”（序号 98）、“封装基板用高解析度感光干膜及配套 PET 膜”（序号 239）、“封装基板用高性能阻焊”（序号 240）列入重点新材料首批次应用示范指导目录。
2023.03	发改委	《做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求明确》	包括光刻胶在内的集成电路产业关键原材料、零配件企业被纳入享受税收优惠政策的清单。
2022.03	深圳市发展和改革委员会	《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025 年）》	明确到 2025 年，建成具有影响力的半导体与集成电路产业集群，产业规模大幅增长，制造、封测等关键环节达到国内领先水平，开展聚酰亚胺、环氧树脂等先进封装材料的研发与产业化，加快光掩模、电子气体等半导体材料的研发生产。
2021.12	工信部	《“十四五”原材料工业发展规划》	围绕集成电路、信息通信等重点应用领域，攻克光刻胶等等一批关键材料。
2021.12	工信部	《重点新材料首批应用示范指导目录（2021 年版）》	将集成电路用光刻胶及其他关键原材料和配套试剂等列为重点新材料。
2021.03	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2020.12	财政部、税务总局等	《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	国家鼓励的集成电路线宽小于 28 纳米(含)，且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税;国家鼓励的集成电路线宽小于 65 纳米(含)，且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税;国家鼓励的集成电路线宽小于 130 纳米(含)，且经营期在 10 年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

发布时间	发布单位	政策名称	核心内容
2020.09	发改委等四部门	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。
2020.07	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率或减半征收企业所得税。
2019.12	工信部	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 版）》	推荐材料:集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂、ArF 光刻胶用脂环族环氧树脂、LCD 用正性光刻胶和 gi 线正性光刻胶用酚醛树脂。
2017.12	发改委	《新材料关键技术产业化实施方案》	要发展高端专用化学品，包括 KrF（248nm）光刻胶和 ArF 光刻胶（193nm），为大型和超大型集成电路提供设备，且单套装置规模达到 10 吨/年。
2017.04	科技部	《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》	重点研发 300 毫米硅片、深紫外光刻胶等关键材料产品。
2017.01	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》	将光刻胶列入“电子核心产业”的“集成电路”项。
2014.06	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	开发光刻胶、大尺寸硅片等关键材料，加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程，增强产业配套能力。

在光刻胶相关积极政策的支持下，公司等部分国内领先企业在光刻胶中高端产品研发已有一定的突破，光刻胶国产化率有望进一步提升，光刻胶行业将快速发展。

2、下游应用领域市场需求广阔，为行业带来发展机遇

本项目线路干膜主要应用于 PCB 及半导体领域，近年来随着上述领域的快速发展，感光干膜市场亦随之扩增。21 世纪以来，全球 PCB、显示、半导体产能逐渐向亚洲尤其是中国大陆转移，带动上游产业链国内需求的快速增长。

PCB 行业市场规模持续增长。PCB 被誉为“电子产品之母”，是电子元器件相互连接的载体，几乎是所有电子产品中不可或缺的元件，其需求受单一行业影响较小，主要受宏观经济周期性波动以及电子信息产业整体发展情况的影响。据 Prismark 公布数据，中国 PCB 市场总产值从 2018 年的 327.1 亿美元增长至 2023

年的 378.0 亿美元，复合增长率为 2.93%。随着电子产业的复苏和下游应用的增长，PCB 产业将迎来新一轮的增长周期，据 PrismaMark 预测，2023 年至 2028 年，全球 PCB 产值的年复合增长率预计将达到 5.4%。受益于自动驾驶、人工智能及高速运算服务器等市场线需求，预计未来中国仍将保持行业的主导制造中心地位。

同时，IC 载板作为集成电路先进封装的关键基材，其市场规模将保持高速增长。根据 PrismaMark 测算，全球 IC 载板的市场规模预计在 2025 年将达到 189.3 亿美元，2018 至 2025 年将实现复合增长率为 14.03% 的增长。

此外，在大硅片占比提高、制程节点升级的背景下，半导体光刻胶市场规模逐渐增加。根据 SEMI 数据，2022 年全球晶圆制造材料市场达 447 亿美元，同比增长 10.5%。随着大硅片、制程升级的趋势呈现，高端光刻胶的需求将会进一步提升，单位面积晶圆消耗的光刻胶价值量不断上升。根据 SEMI、WSTS 和海通国际的数据，2022 年全球半导体光刻胶市场规模约 26.4 亿美元，预计 2030 年将增长至 45 亿美元，年均复合增长率为 6.9%。

综上，在 PCB 行业规模增长、半导体产业升级等背景下，PCB 光刻胶、IC 载板光刻胶和半导体光刻胶等行业终端领域市场需求的进一步扩大，将拉动市场对光刻胶产品的需求，推动光刻胶行业市场规模扩大。

3、下游领域国产化带动光刻胶国产化率上升，高端干膜光刻胶产品国产替代需求迫切

半导体国产化率上升为国产光刻胶创造机遇。感光干膜处于 PCB 产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件及部件的功能和性状构成重要影响。近年来，全球 PCB、显示、半导体产能逐渐向亚洲尤其是中国大陆转移，带动上游产业链国内需求的快速增长，行业呈明显的进口替代趋势。根据 PrismaMark 数据，中国大陆 PCB 产值占全球产值的比例从 2000 年的 8.1% 增长至 2023 年的 54.4%，成为全球主要 PCB 制造基地，预计未来中国在 PCB 产业链的主导地位将得到进一步巩固。受益于 PCB 行业产能转移，其上下游产业也呈现出国产化发展趋势。

目前我国半导体光刻胶国产化率较低。由于 PCB、半导体领域的技术壁垒依

次提高，并且我国半导体行业起步较晚，从原料采购到终端产品生产，整条产业链都较为依赖进口。中国光刻胶国产化率情况具体如下：

按照应用领域分类	主要品种	国产化率
PCB 光刻胶	干膜光刻胶	一般商用感光线路干膜国产化率约 50%， 高端感光线路干膜国产化率不足 20%， 阻焊干膜近乎全进口
	湿膜及阻焊油墨	一般商用阻焊油墨国产化率约 50%， IC 载板用阻焊油墨全进口
半导体光刻胶	g 线光刻胶	20%
	I 线光刻胶	20%
	KrF 光刻胶	小于 5%
	ArF 光刻胶	小于 1%
	EUV 光刻胶	研发阶段

资料来源：方正证券整理

我国光刻胶行业已在部分领域取得突破，但在高端干膜光刻胶方面，由于技术壁垒较高，并且我国产业链起步较晚，目前国产化率较低。干膜光刻胶根据应用方式及用途的不同，分为感光线路干膜及阻焊干膜，其中，感光线路干膜应用于 PCB 制造过程中电路设计的图形转移，而阻焊干膜则在固化后作为永久阻焊层，起保护线路的作用。

感光线路干膜按照 PCB 下游应用领域中线路对干膜分辨率及精度的要求，可分为一般商用感光线路干膜和高端感光干膜，具体为：按照解析度区分，干膜分辨率在 $50\ \mu\text{m}$ 及以上的统称为一般感光干膜，干膜分辨率在 $25\ \mu\text{m}$ 及以下的称为高端感光干膜，具体如下：

干膜光刻胶分类	用途	技术指标及发分类	下游应用领域	国产化率
线路干膜光刻胶	应用于 PCB 制造过程中电路设计的图形转移	一般商用感光线路干膜：分辨率达 $50\ \mu\text{m}$	车载电源板、电脑主机板、家电线路板等	约 50%
		高端感光线路干膜：分辨率达 $25\ \mu\text{m}$ 以下	HDI 板、半导体显示用面板、半导体引线框架、IC 载板等	不足 20%

随着电子技术的日益发达，电子芯片、电子线路板愈发精细，高精度感光线路干膜的应用比例不断增加，高精度、高感度、高性价比的高端感光线路干膜产

品是市场需求未来发展方向，目前国产化率不足 20%，存在较大的国产替代需求空间。而在 IC 载板用阻焊干膜这一高端领域，目前由日本太阳油墨公司、日本 Resonac 公司垄断，内资供应尚处于空白状态。

国家政策支持推动光刻胶的国产化替代进程。近年来，为推动国产化进程，我国不断出台相关积极政策，如《石化和化学工业发展规划》《新材料关键技术产业化实施方案》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》《国家集成电路产业发展推进纲要》等，助力全产业链国产化。2023 年 12 月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》（以下简称“首批次目录”），“通用型半高感 LDI 光致抗蚀干膜”（序号 98）、“封装基板用高解析度感光干膜及配套 PET 膜”（序号 239）、“封装基板用高性能阻焊”（序号 240）已列入重点新材料首批次应用示范指导目录。其中，一般商用感光线路干膜、高端感光线路干膜分别符合对应上述首批次目录的序号 98、序号 239 产品，而 IC 载板阻焊干膜（固态）与序号 240 产品（液态阻焊）同属封装基板用高性能阻焊类产品，亦是国家重点引导的新材料。积极政策的出台与下游产业快速发展必然也会推动国产光刻胶行业的发展。

综上，半导体国产化率上升为国产光刻胶创造了机遇，虽然目前中国的中高端光刻胶产品国产化率较低，但是在相关政策的支持以及上下游产业链一体化发展的推动下，未来高端光刻胶相关全产业链国产化将会加速。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、顺应行业趋势，优化产品结构，积极扩张产能

公司响应国家产业政策的号召，积极参与光刻胶国产化替代进程。随着 5G、智能驾驶、人工智能、物联网等下游创新应用的逐步成熟，PCB、显示、半导体等光刻胶的主要应用领域蓬勃发展，带动光刻胶市场需求快速增长。公司在感光电子化学品行业深耕多年，具备深厚的技术实力和丰富的行业经验积累。公司本次募集资金投资项目中，高端感光线路干膜光刻胶建设项目是公司顺应产业发展趋势、响应下游客户需求、优化公司产品结构做出的重要布局，符合，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于进一步提升公司盈利能力，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能

力提升项目将助力公司布局相关领域，提升产品研发设计效率，加速高端 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶产品国产化突破。

2、提高盈利能力，优化资产负债结构，促进可持续发展

通过本次发行和募投项目的实施，公司将新增感光干膜光刻胶产能，有利于公司培育新的盈利增长点。同时，随着公司业务规模的不断扩张，仅依靠自有资金及债务融资已较难满足公司战略目标，本次发行的募集资金将为公司业务发展提供资金支持，有利于公司核心业务的增长和公司战略的实施。本次发行将缓解公司的资金压力，优化资产负债结构，降低公司资产负债率水平，提高盈利能力，促进公司可持续发展。

3、满足公司业务发展的流动资金需求，增强公司抗风险能力

在国产化替代的行业趋势下，国内光刻胶市场持续增长。同时，光刻胶行业的技术壁垒较高，下游产业对产品性能要求也不断提升，为把握市场发展机遇、保持技术领先、巩固行业地位，公司在业务规模扩张、技术研发投入、产品结构优化等方面，均需要大量的流动资金投资。同时随着公司业务规模的扩大，采购、生产、研发以及市场开拓等多个营运环节的资金需求迅速增长。本次向特定对象发行股票部分募集资金将用于补充流动资金，有利于缓解公司业务扩张和研发投入带来的运营资金压力，满足流动资金需求，同时增强公司抗风险能力。

三、发行对象及其与公司的关系

本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

截至本预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在竞价结束后公告的文件中予以披露。

四、本次发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

（三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个

交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2023 年年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。

（五）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，由公司 2023 年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产 20%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行数量上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

（六）限售期及上市安排

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的

股票还需遵守法律法规、规范文件和深交所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

（七）上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

（八）本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润，将由发行完成后的新老股东按本次发行后的股份比例共享。

（九）本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

（十）募集资金投向

本次发行拟募集资金总额不超过 24,500 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	高端感光线路干膜光刻胶建设项目	17,591.65	12,373.00
2	IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目	10,179.75	9,695.00
3	补充流动资金	2,432.00	2,432.00
合计		30,203.40	24,500.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分

由公司自有或自筹资金解决。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次以简易程序向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在询价结束后公告的《募集说明书》中予以披露。

六、本次发行不会导致公司控制权发生变化

截至 2024 年 4 月 30 日，林海望、杨遇春、黄勇和刘启升四人持有公司合计 112,365,603 股，占比 45.60%，为公司共同实际控制人。

本次发行预计不会导致上市公司控制权发生变更。

七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）已履行的审批程序

2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2024 年 4 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。

根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）尚需履行的审批程序

- 1、竞价完成后，公司董事会审议通过本次发行具体方案；
- 2、深交所审核并作出上市公司是否符合发行条件和信息披露要求的审核意见；
- 3、中国证监会对上市公司的注册申请作出注册或者不予注册的决定。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 24,500 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	高端感光线路干膜光刻胶建设项目	17,591.65	12,373.00
2	IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目	10,179.75	9,695.00
3	补充流动资金	2,432.00	2,432.00
合计		30,203.40	24,500.00

在本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析

(一) 高端感光线路干膜光刻胶建设项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 17,591.65 万元,建设地点位于珠海市南水镇平湾四路东北侧,实施主体为公司全资子公司珠海容大。

本项目主要建设内容包括:年产 1.20 亿平方米高端感光线路干膜光刻胶项目。本项目中的感光线路干膜产品较目前干膜产品厚度更为精细,可用于半导体引线框架、半导体显示用基板、柔性 PCB 精密基板、手机通讯高密度基板等高精度市场。本项目建成投产后,公司将新增 1.20 亿平方米感光线路干膜产能,将

有效满足公司大力拓展下游应用领域市场的业务需求，为夯实公司市场地位、保障公司未来业绩持续增长奠定基础。

2、项目实施的必要性

(1) 响应国家产业政策号召，推动干膜光刻胶产业加速升级及高端干膜实现国产突破

感光干膜是用于 PCB 制造的重要原材料。感光干膜是覆铜板图形刻蚀的关键材料，在制造加工过程中，贴合在覆铜板上的感光干膜经紫外线的照射之后发生聚合反应，形成稳定物质附着于铜板上，从而达到阻挡电镀、刻蚀和掩孔等功能，实现 PCB 设计线路的图形转移。

我国在高端干膜光刻胶产业方面，由于技术壁垒较高，并且我国产业链起步较晚，目前国产化率较低。2023 年 12 月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，将“通用型半高感 LDI 光致抗蚀干膜”（序号 98）、“封装基板用高解析度感光干膜及配套 PET 膜”（序号 239）、“封装基板用高性能阻焊”（序号 240）列入重点新材料首批次应用示范指导目录，积极推进干膜光刻胶行业的发展及产业升级，加速高端干膜光刻胶的国产突破。

公司积极响应国家产业政策的号召，积极参与并推动中高端干膜光刻胶国产化替代进程。随着下游市场对干膜需求的持续增长，更高精度、更高感度以及更高性价比的感光干膜产品迫切的国产替代需求的背景下，公司通过本次募投项目扩大干膜光刻胶产能，建设高端感光线路干膜光刻胶项目（产品对应首批次目录序号 98 及序号 239），产品将应用于半导体引线框架、半导体显示用基板、柔性 PCB 精密基板、手机通讯高密度基板等精密应用领域，有利于公司进一步布局并抢占高端感光干膜产品市场，推动干膜光刻胶产业加速升级及高端干膜实现国产突破，对于干膜光刻胶产业及国家产业链实现自主可控具有深远意义。

(2) 开拓高精度感光干膜市场，实现产品结构升级，拓展新的盈利增长点

随着下游 PCB 行业的蓬勃发展，全球感光干膜市场规模持续增长。PCB 被誉为“电子产品之母”，是电子元器件相互连接的载体，几乎是所有电子产品中不可或缺的元件，其需求受单一行业影响较小，主要受宏观经济周期性波动以及

电子信息产业整体发展情况的影响。根据华经产业研究院数据显示,2021 至 2023 年全球感光干膜的出货量将由 11.91 亿平方米增长至 13.05 亿平方米,年复合增长率为 4.7%,感光干膜市场规模持续增长。根据 PrismaMark、国金证券研究所数据显示,2023 至 2027 年全球 PCB 市场规模将由 784 亿美元增长至 984 亿美元,年复合增长率为 5.8%,感光干膜约占 PCB 产业总成本的 3%,因此预计全球感光干膜的市场规模将由 2023 年的 24 亿美元增长至 2027 年的 30 亿美元。

在感光干膜市场持续增长的背景下,高精度感光干膜目前的占有率及国产化率较低。按照 PCB 下游应用领域对光致抗蚀干膜精度的要求,可分为一般商用感光线路干膜和高精度感光线路干膜。目前,在感光线路干膜的需求中仍以一般商用感光线路干膜为主,但随着电子技术的日益发达,电子芯片、电子线路板愈发精细,高精度感光干膜的应用比例不断增加,高精度、高感度、高性价比的感光干膜产品是市场需求未来发展方向。同时,一般商用感光线路干膜国产化率约 50%,而高端感光线路干膜国产化率不足 20%,随着相关产业的创新升级及产业链国产替代的需要,高端感光线路干膜存在巨大的增长空间。

公司现有主营产品已覆盖感光干膜产品,具有产品升级研发的基础。公司自 2018 年开始便组建研发团队负责该领域的技术攻关,目前,公司现有感光干膜类型主要为抗电镀干膜、精细线路干膜,分别用于普通 PCB 外层抗电镀及普通 PCB 内层抗蚀刻,具有研发高端感光线路干膜的技术基础。本次募投项目系公司为了进一步布局并抢占高端感光干膜产品市场。

在下游市场对干膜需求的持续增长,更高精度、更高感度以及更高性价比的感光干膜产品迫切的国产替代需求的背景下,公司通过本次募投项目扩大干膜光刻胶产能,建设高端感光线路干膜光刻胶项目,应用于半导体引线框架、半导体显示用基板、柔性 PCB 精密基板、手机通讯高密度基板等精密应用领域,目前已通过部分客户的验证并实现小批量供货。本次募投项目的实施,有利于公司进一步布局并抢占高端感光干膜产品市场、持续优化提升公司产品结构,从而夯实公司市场地位及竞争力,保障公司未来业绩持续增长。

(3) 顺应进口替代的行业发展趋势,提升公司规模优势、开拓高端产品路线,提升市场开拓能力

在国家政策支持、下游市场发展、持续研发投入等因素的综合影响下，我国感光干膜光刻胶行业市场规模增长迅速。根据上市公司福斯特(5603806.SH)2021年公开披露的信息，感光干膜市场空间在百亿人民币级别。根据 Prisma、国金证券研究所数据显示，2023 至 2027 年全球 PCB 市场规模将由 784 亿美元增长至 984 亿美元，年复合增长率为 5.8%，则感光干膜市场规模亦将继续保持增长。PCB、半导体显示面板和集成电路产业国产化进程加速、产业链自主可控需求迫切的背景下，作为上游关键材料的干膜光刻胶呈现明显的进口替代趋势，国产干膜光刻胶或将迎来快速发展的机遇。

通过本次募投项目的实施，公司将新增 1.20 亿平方米感光干膜的自主生产产能，其中新建高端感光线路干膜光刻胶产线所生产干膜产品较公司目前的干膜产品厚度更为精细，可用于半导体引线框架、半导体显示用基板、柔性 PCB 精密基板、手机通讯高密度基板等高精度市场。本项目建成投产后，公司将新增 1.20 亿平方米感光线路干膜产能，一方面将进一步加强公司的规模优势，匹配客户日益增长的需求，另一方面将开拓高端产品线路以拓展下游客户订单、加大与现有客户的合作力度，大幅提升市场开拓能力。

3、项目实施的可行性

(1) 公司具有完备的生产体系和优质的客户资源，为募投项目的有序开展和产能消化奠定基础

公司具有完备的光刻胶产品生产体系。公司的感光干膜主要应用于半导体及 PCB 领域，客户终端产品呈现小型化、轻薄化、高性能化、多功能化趋势，因此客户会从产品质量、技术水平、生产效率、售后服务等多个角度进行严格的筛选。公司具备完善的产品质量控制体系，并通过了优质客户资源的认证。在现有完善的生产管理体系加持下，公司可有序、稳定地实现批量化生产，为项目有序开展奠定基础。

同时，公司具有优质的客户资源。公司自设立以来，一直致力于电子化学品的研发、生产和销售，凭借产品性能的优势，公司积累了优质的客户资源。在 PCB 领域，公司拥有在业内知名的大连崇达电路有限公司、深南电路股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司、胜宏科技（惠州）股份有限公司等多家客户，与

上述客户建立了长期、稳定的合作关系。本次募投项目涉及的产品之一为感光干膜，主要应用于 PCB 领域，与公司现有客户群体基本一致。

报告期内，公司一般商用感光线路干膜产品已实现量产销售。而在高端感光线路干膜产品方面，公司应用于半导体引线框架、半导体显示用基板、柔性 PCB 精密基板、手机通讯高密度基板等精密应用领域的高精度感光干膜新产品目前已通过部分客户的验证并小批量供货，并在积极推进其他重要客户的验证工作。

本项目实施后，公司将新增 1.20 亿平方米感光线路干膜产能。凭借完备的生产体系和优质的客户资源，公司具备有序建设募投项目及充分消化产能的能力，以保证项目的正常推进。

(2) 产品核心技术积累深厚，为本项目实施保驾护航

公司长期致力于光刻胶产品的开发，主营产品包括 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等一系列拥有核心自主知识产权的光刻胶等。公司经过多年的自主研发和实践积累，掌握了树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等电子感光化学品核心技术。

同时，公司拥有一支经验丰富、作风严谨、创新能力强、行业技术领先的研发团队，组建了完整的产品研发、设计、工艺、质量控制的人才队伍，能够准确把握行业发展动态、积极开发新技术和新产品，为企业持续稳定发展做支撑。

公司现有主营产品已覆盖感光干膜产品，具有产品升级研发的基础。公司自 2018 年开始便组建研发团队负责该领域的技术攻关，目前，公司现有感光干膜为一般商用感光线路干膜产品，类型主要为抗电镀干膜、精细线路干膜，分别用于普通 PCB 外层抗电镀及普通 PCB 内层抗蚀刻，具有研发高端感光线路干膜的技术基础。同时，公司的高端感光线路干膜新产品已实现技术突破并研发成功，目前已通过部分客户的验证并进行小批量供货。

因此本项目的实施具有较好的研发基础和人才储备基础，有较为成熟的技术支撑和人力支撑，在研发方面具有较高的可行性。

(3) 进口替代的行业趋势和持续政策红利，为募投项目的实施创造良好的市场条件

21 世纪以来，全球 PCB、显示、半导体产能逐渐向亚洲尤其是中国大陆转移，带动上游产业链国内需求的快速增长，行业呈明显的进口替代趋势。光刻胶作为关键电子材料，是国家战略新兴产业，最终广泛应用于消费电子、汽车、航空航天、军事装备等行业。在产业链自主可控的战略目标下，近年来，我国陆续出台多项政策促进行业发展。2023 年 12 月，发改委印发《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，将“光刻胶”等电子元器件生产专用材料列为鼓励类项目；同月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，将“通用型半高感 LDI 光致抗蚀干膜”（序号 98）、“封装基板用高解析度感光干膜及配套 PET 膜”（序号 239）、“封装基板用高性能阻焊”（序号 240）列入重点新材料首批次应用示范指导目录。公司迎来持续的政策红利。进口替代的行业趋势和持续政策红利，为本次募投项目实施创造了良好市场条件。

公司等部分国内领先企业在中高端干膜光刻胶产品研发已有一定的突破，干膜光刻胶国产化率有望进一步提升。本次募投项目实施具备广阔的市场空间和良好的外部政策环境。

4、项目投资概算

本项目总投资 17,591.65 万元，其中建设投资（不含预备费）12,373.00 万元，预备费 618.65 万元，铺底流动资金 4,600.00 万元，具体投资安排如下：

序号	投资构成	金额	占比
1	建设投资	12,991.65	73.85%
1.1	设备购置费用	12,373.00	70.33%
1.2	预备费	618.65	3.52%
2	铺底流动资金	4,600.00	26.15%
	合计	17,591.65	100.00%

注：预备费和铺底流动资金由公司自有资金或通过其他融资方式解决，不涉及本次募集资金。

5、项目建设期

本项目建设期为 2.5 年，包括产线规划、设备订购、设备安装调试、试运行等内容。

6、项目经济效益分析

经测算，本项目满产后，预计年均营业收入为 59,819.76 万元，年均税后利润为 7,200.16 万元；本项目税后内部收益率为 19.14%，所得税后静态投资回收期为 8.06 年，项目预期效益良好。

7、项目报批事项及土地情况

本项目拟建设地点位于珠海市南水镇平湾四路东北侧。本项目已在广东省投资项目在线审批监管平台完成备案登记，备案项目代码为 2310-440404-04-01-861680。

截至本报告公告日，本项目的环评手续正在办理过程中。

（二）IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 10,179.75 万元，实施地点位于珠海市南水镇平湾四路东北侧，实施主体为公司全资子公司珠海容大。

公司计划通过珠海容大实施 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目，将围绕“IC 载板阻焊干膜光刻胶”、“248nm 光刻胶关键原材料测试评估”、“248nm 厚膜正胶产品开发”、“248nm 负性 lift-off 光刻胶产品开发”、“248nm 高分辨正胶产品开发”、“248nm 光刻胶光刻工艺开发”等 6 大研发课题进行研究，旨在提升公司在 IC 载板阻焊干膜光刻胶、KrF 半导体光刻胶的研发能力，为后续丰富产品体系奠定基础，实现自身可持续发展。

2、项目实施的必要性

（1）布局 IC 载板高端阻焊干膜领域，促进产业链国产替代、自主可控

IC 载板用阻焊干膜性能优异，是国家支持发展的材料之一。IC 载板用阻焊干膜具有优异的性能，系高端光刻胶类别之一，可作为阻焊层的应用方案，可应用于半导体领域 IC 载板生产制造，以匹配芯片封装的精细要求。相较于传统的液态型阻焊油墨，阻焊干膜不需要进行丝印（或辊涂）、静置、预烘干等工序，

可以节省复杂工序，缩短工艺制程，从而提高生产稳定性及提升产品良率。IC 载板用阻焊干膜形成的阻焊层在表面平整性、开窗（PAD/SRO）精细程度、可靠性（高温高湿耐性、机械性能）等方面品质更为优越，且产品本身的环保性更为优良，能够为下游客户提供更为高效、高质量、环保的解决方案。根据工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，“封装基板用高性能阻焊”（序号 240）已列入重点新材料首批次应用示范指导目录，而 IC 载板阻焊干膜（固态）与序号 240 产品（液态阻焊）同属封装基板用高性能阻焊类产品，系国家及产业政策重点支持引导的高新技术材料。

目前阻焊干膜的国产替代化率极低，而 IC 载板用阻焊干膜更是近乎全进口，目前由日本太阳油墨公司、日本 Resonac 公司垄断，内资供应尚处于空白状态。

公司提前重点布局 IC 载板阻焊干膜光刻胶市场，以匹配下游封装基板厂商的研发、量产需求，对于促进干膜光刻胶产业链加速国产替代、实现自主可控具有深远意义。项目建成后，公司将打破高端阻焊干膜光刻胶的国外垄断局面，公司的产品矩阵亦将得以进一步拓展，有利于持续提高公司产品竞争力，推动公司长远高质量发展。

（2）半导体下游扩产和制程升级驱动半导体光刻胶市场成长，募投项目有望填补客户对高端光刻胶的需求

在下游扩产需求旺盛、大硅片和制程升级的背景下，半导体光刻胶市场规模逐渐增加。受益于 5G、物联网、新能源汽车、人工智能等新兴领域的高速成长，半导体材料市场同步保持高速增长。根据 SEMI 数据，2022 年全球晶圆制造材料市场达 447 亿美元，同比增长 10.5%。同时，随着大硅片、制程升级的趋势呈现，单位面积晶圆所需光刻胶价值量提升。根据 SEMI、WSTS 和海通国际的数据，2022 年全球半导体光刻胶市场规模约 26.4 亿美元，预计 2030 年将增长至 45 亿美元，年均复合增长率为 6.9%。

中国半导体光刻胶的市场规模将快速增长。伴随着第三次半导体产业转移，晶圆产能向大陆转移，我国大陆地区在全球半导体材料市场占比同步提升，预计未来国内半导体光刻胶市场将保持高于全球市场的增速持续成长。根据

TrendBank 的预测，中国半导体光刻胶市场规模预计将由 2023 年的 34 亿元增长至 2026 年的 48 亿元，年均复合增长率约为 12%。

在上述背景下，公司将围绕“248nm 光刻胶关键原材料测试评估”、“248nm 厚膜正胶产品开发”、“248nm 负性 lift-off 光刻胶产品开发”、“248nm 高分辨正胶产品开发”、“248nm 光刻胶光刻工艺开发”等课题进行研究，提升自身在 KrF 半导体光刻胶的研发能力，在日趋激烈的市场竞争中保持技术先发优势，填补下游客户对国产高端半导体光刻胶的需求，实现自身可持续发展。

(3) 光刻胶是半导体制造关键材料，国产替代、自主可控需求迫切

光刻胶是半导体制造关键材料。光刻是精细线路图形加工中最重要工艺，通常半导体芯片在制造过程中需要进行数十道光刻过程，光刻胶是光刻工艺中最重要耗材，其质量和性能与电子器件良品率、器件性能以及器件可靠性直接相关。

目前，全球半导体光刻胶市场由日美韩厂商主导。2021 年，东京应化、JSR、住友化学、富士胶片等四家日本企业分别约占 27%、13%、12%、8% 的市场份额，美国杜邦、韩国东进分别约占 17%、11% 的市场份额，以上六家企业合计约占 88% 的市场份额。

光刻胶是半导体制造的关键材料，其自主可控的国产化替代需求迫切。为推动光刻胶等半导体材料行业的发展，国家、地方层面先后出台相关政策，2023 年 3 月，发改委等五部门联合印发《国家发展改革委等部门关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，包括光刻胶在内的集成电路产业关键原材料、零配件企业被纳入享受税收优惠政策的清单。

公司本次半导体光刻胶研发能力提升项目响应国家支持半导体产业发展政策，有助于填补国内相关供应链的空白，加速国产化替代进程。

(4) 公司具有半导体光刻胶研发基础，升级设备可大幅提升产品研发效率

公司经过多年的自主研发和实践积累，是国内为数不多掌握光刻胶树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等制造半导体光刻胶核心技术的企业。光

刻胶由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等不同性质的原料，是一种经过严格设计的复杂、精密的配方产品。随着公司产品应用领域不断拓展，公司的研发项目随之增加。目前，公司现有实验设备、检测设备已逐渐无法满足高端半导体光刻胶的研发创新需求。

为不断增强自身创新性研发能力，公司拟通过本项目购置业内先进的专业化实验设备，其中 248nm 扫描式光刻机可用于高端 DUA 光刻胶产品研发和量产检测；涂胶显影一体机可以用于 g 线和 i 线产品的研发，还可以用于 248nm 光刻胶产品的研发。

通过升级研发设备，公司可以加快项目进度和产品验证，缩短产品研发周期，为产品国产化替代创造有利条件。

3、项目实施的可行性

(1) 现有客户存在高端光刻胶产品需求，为募投项目的有序开展和产能消化提供保障

公司凭借客户提供优质产品及优质服务作为根本立足点，在行业内树立了良好的口碑，已与国内知名客户建立稳健的合作关系。IC 载板用阻焊产品方面，公司目前已实现 IC 载板用液态阻焊油墨产品的技术攻关，目前处于市场推广阶段，其在封装基板关注的 SRO 能力、undercut、BHAST 耐性等性能方面具有一定优势。而本募投项目将在液态阻焊油墨产品的技术基础上，进行液态阻焊油墨干膜化的技术研发及工艺探索。

此外，半导体光刻胶方面，公司与华微电子（股票代码：600360）、士兰微（股票代码：600460）、扬杰科技（股票代码：300373）等半导体领域知名公司均与公司合作多年，为其提供 i 线光刻胶、g 线光刻胶等产品，且上述客户具备 KrF 光刻胶的需求。

在上述优质客户及下游需求迫切的背景下，公司积极投入资源进行相关产品的研发，通过与各下游行业领先企业的深度合作进行产品布局、积累成熟解决方案，以此形成持续的良性循环，将为阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发的有序开展及其研究成果的产能消化提供有效保障。

(2) 公司具有相关产品的研发经验和专业研发管理团队，为项目顺利实施奠定基础

公司具有相关产品的研发经验。经过多年的自主研发和实践积累，公司掌握了树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等电子感光化学品核心技术。同时，在多年持续研发、工艺持续迭代和应用持续创新的背景下，公司已取得发明专利逾 40 项。公司可将丰富的技术储备广泛应用于阻焊干膜光刻胶和半导体光刻胶课题的研究，保障本项目的顺利实施。同时，公司具备专业的研发及管理团队。公司核心研发管理团队从事感光电子化学品领域产业研发工作多年，为项目实施提供重要基础。

4、项目投资概算

本项目总投资 10,179.75 万元，其中建设投资（不含预备费）9,695.00 万元，预备费 484.75 万元，具体投资安排如下：

序号	投资构成	金额	占比
1	建设投资	10,179.75	100%
1.1	设备购置费用	9,695.00	95.24%
1.2	预备费	484.75	4.76%
	合计	10,179.75	100%

注：预备费由公司自有资金或通过其他融资方式解决，不涉及本次募集资金。

5、项目经济效益分析

本项目为研发能力提升项目，不直接产生经济效益。项目建成后，将显著提升公司 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶业务的技术水平和研发能力。

6、项目报批事项及土地情况

本项目拟建设地点位于珠海市南水镇平湾四路东北侧。本项目已在广东省投资项目在线审批监管平台完成备案登记，备案项目代码为 2310-440404-04-01-861680。

截至本报告公告日，本项目的环评手续正在办理过程中。

(三) 补充流动资金

1、项目基本情况

本次向特定对象发行股票，公司拟使用募集资金 2,432.00 万元用于补充流动资金，以满足未来业务发展的资金需求，提升持续盈利能力，优化资本结构，降低财务费用，提高抗风险能力。

2、项目实施的必要性和可行性

（1）满足未来业务发展的资金需求，助力公司业务扩张

公司自成立以来，一直致力于感光电子化学品的研发、生产和销售，产品主要应用于 PCB、显示、半导体等领域，并最终广泛应用于消费电子、汽车、航空航天、军事装备等行业。随着市场需求的持续增长以及公司经营规模的持续扩大，公司在业务规模扩张、技术研发投入、产品结构升级优化等方面，均需要大量的流动资金投资；同时公司在采购、生产、研发以及市场拓展等多个营运环节中资金需求迅速增加，流动资金需求较高。因此，本次公司拟使用募集资金 2,432.00 万元补充流动资金，为未来经营发展提供资金保障，助力公司业务扩张。

（2）为研发战略实施提供资金保障，提高公司的市场竞争力

光刻胶行业的技术壁垒较高，并且下游产业对产品性能要求不断提升，为持续保持公司的市场竞争力，未来公司将持续投入研究开发新产品、新技术，提高产品性能，扩充产品矩阵。本次补充流动资金有利于公司在技术研发、工艺创新、产品开发等方面持续投入，满足经营规模快速扩张带来的资金需求，从而为公司战略实施提供资金保障，提高公司的市场竞争力。

（3）优化资本结构，增强抗风险能力

近年来，随着经营规模的不断扩张，公司资金需求持续增长，同时也导致公司资产负债率不断提高。截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 18.67%。通过本次发行补充流动资金，有利于降低资产负债率、优化资本结构，有利于公司增强抗风险能力和提高可持续发展能力。本次补充流动资金综合考虑了公司业务发展情况、现金流状况、资本结构以及预期运营资金缺口等因素，整体规模适当，具备合理性。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

（一）本次发行对公司业务与资产的影响

公司响应国家产业政策的号召，积极参与光刻胶国产化替代进程。公司的主营业务为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等感光电子化学品的研发、生产和销售，主要产品为 PCB 感光油墨、PCB 感光干膜、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列感光电子化学品。公司本次发行募集资金围绕主营业务展开，其中高端感光线路干膜光刻胶建设项目是公司顺应产业发展趋势、响应下游客户需求、优化公司产品结构做出的重要布局，符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于进一步提升公司盈利能力，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目将助力公司布局相关领域，提升产品研发设计效率，加速高端 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶产品国产化突破。同时，部分募集资金用于补充营运资金将进一步增强公司资金实力，优化资本结构，为经营活动的高效开展提供有力支持。

本次发行完成后，公司的主营业务范围不会产生重大变化，公司亦暂无业务及资产整合计划。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司注册资本、股本总额及股本结构将发生变化，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更登记。

（三）本次发行对公司股东结构的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。本次发行不会导致公司控股股东与实际控制人发生变化。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

截至本预案公告日，公司尚无调整高级管理人员的计划，本次发行亦不会对高级管理人员结构造成重大影响。本次发行完成后，若公司拟调整高级管理人员，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务结构的影响

本次募集资金投资项目系公司对主营业务的进一步拓展与强化，项目实施后将增强公司主营业务的收入规模与盈利能力，优化产品结构以及主营业务收入结构。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，营运资金更加充裕，资产负债结构更为合理。本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债能力，降低财务风险，为公司保持长期稳健发展奠定坚实基础。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行是公司顺应产业发展、响应客户需求、增强竞争能力的重要战略布局。由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，因此短期内公司每股收益和净资产收益率将相应出现一定程度的下降。但从长远来看，随着募集资金投资项目的投产和效益的实现，公司盈利能力和市场竞争力将不断增强，本次发行将对公司未来的财务指标产生积极影响。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，募集资金的到位将使得公司筹资活动产生的现金流入金额大幅增加；在募集资金具体投入项目后，投资活动产生的现金流出金额也将大幅

增加；随着募投项目的实施和效益产生，公司盈利能力不断增强，经营活动产生的现金流入金额将逐步增加。

三、公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有完全自主的独立经营能力。本次发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务、管理关系和同业竞争状况不会发生重大变化。本次发行也不会导致公司与实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不会因本次发行产生被主要股东及其关联人占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 18.67%。本次发行完成后，公司资产负债率将有所下降，有利于改善整体财务状况，优化资产负债结构，降低财务风险，公司整体抗风险能力和持续经营能力进一步增强。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）募集资金投资项目风险

1、募投项目新增产能消化风险

本次发行相关的募投项目均围绕公司主营业务开展，是公司基于当前的产业政策、发展趋势、市场需求、公司经营状况等因素，经审慎论证后确定的，具有

较强的可行性和必要性，符合公司的战略规划和经营需要。但是，募投项目的实施和效益产生均需一定时间，因此从项目实施、完工、达产以至最终的产品销售等均存在不确定性。若在募投项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境、技术路线等发生重大不利变化，下游需求增长缓慢，公司市场开拓成效不佳，所处行业竞争加剧，都可能导致公司新增产能面临无法消化的市场风险。

2、募投项目效益不及预期的风险

本次发行相关的募投项目均围绕公司主营业务开展，高端感光线路干膜光刻胶建设项目税后内部收益率为 19.14%，项目预计效益水平是在综合考虑了公司现有业务盈利水平、同行业类似项目或类似业务盈利水平、预计市场空间、市场竞争程度等因素基础上做出的审慎预测。

但募投项目的实施和效益产生均需一定时间，因此从项目实施、完工、达产以至最终的产品销售等均存在不确定性。若在募投项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，产品技术路线发生重大更替，下游需求增长缓慢，公司产品验证进展不顺或市场开拓成效不佳，所处行业竞争加剧，公司产品销售价格持续下降以及其他不可预计的因素出现，都可能对公司募投项目的顺利实施、业务增长和预期效益造成不利影响。

3、募投项目涉及的新产品开拓风险

感光干膜建设项目投产后，公司光刻胶细分产品感光干膜产能将进一步扩大，公司需具备充分的产能消化能力。本次募投项目是公司顺应产业发展、响应客户需求、提升核心竞争力的重要战略布局。虽然公司已对募集资金投资项目的可行性进行了充分地分析和论证，并且公司已在新产品的技术基础、生产工艺和产能消化等方面做了充分准备，但如果项目无法顺利投产，或因建成投产后市场环境发生较大不利变化、公司产品的前期认证和市场开拓进展不畅等因素影响，将对公司募投项目的实施及产品的开拓产生一定的不利影响。

4、募投项目新增折旧、摊销费用导致的利润下滑风险

本次募投项目建成后，每年将会产生一定的固定资产、无形资产折旧摊销费用。尽管公司对募投项目进行了充分论证和可行性分析，但上述募投项目收益受

宏观经济、产业政策、市场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响，若未来募投项目的效益实现情况不达预期，募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

（二）管理风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司经营规模将进一步扩张，对公司战略规划实施、资源整合、市场开拓、人员管理、销售管理、财务管理等方面提出了更大的挑战与更高的要求。如果公司不能持续有效地提升经营管理能力，导致组织建设和管理体系不能完全适应业务规模的扩张，将会削弱公司的市场竞争力，并对公司经营成果和盈利状况造成不利影响。

（三）原材料价格波动风险

公司主营业务成本构成中，原材料成本占比较大。原材料的价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力，若未来宏观经济波动或市场供需不平衡等因素导致原材料价格大幅波动，或者主要原材料供应出现短缺等情形，公司未能及时有效应对，将会对经营业绩造成不利影响。

（四）市场竞争加剧的风险

近年来，随着国内其他感光电子化学品企业的快速发展，以及具有技术、资金、渠道等多方面优势的行业内外资企业在我国生产基地的陆续建成，行业竞争日趋激烈。如果公司不能在技术、品牌、产品性能及成本等方面继续保持竞争优势，日益激烈的市场竞争会对公司的市场份额、盈利水平产生不利影响。

（五）股价波动的风险

公司股票的二级市场价格受多种因素影响而上下波动，除了公司经营业绩、财务状况及所处行业发展前景等基本面因素之外，国家财政政策及货币政策、国际资本市场环境、市场买卖双方力量对比以及投资者心理预期均可能影响股票价格走势。股票价格具有不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。

（六）摊薄即期回报的风险

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需一定时间，因此短期内公司每股收益和净资产收益率将相应出现一定程度的下降，存在股东即期回报被摊薄的风险。

（七）审批风险

本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。本次发行能否通过相关审批机构的批准以及最终通过批准的时间均存在一定的不确定性。

（八）发行风险

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定对象，且最终根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。本次向特定对象发行股票的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

（九）不可抗力和其他意外因素的风险

不排除因政治、经济、自然灾害、疫情等不可抗力因素或其他意外因素对公司生产经营带来不利影响的可能性。

第四节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》明确了利润分配政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）的要求，具体如下：

“第一百五十七条 公司的利润分配政策为：

1、利润分配原则。公司将重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持一致性、合理性和稳定性。

2、利润分配形式。公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（1）在符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况下，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于合并口径当年实现的可分配利润的百分之二十。如果公司当年现金分红的利润已超过合并口径当年实现的可分配利润的百分之二十或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过合并口径当年实现的可分配利润的百分之二十，对于超过部分公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（2）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

④公司发展阶段不易区分的，由董事会审议确定发展阶段。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，且超过 5,000 万元。

3、利润分配的时间间隔。公司原则上每年进行一次年度利润分配，董事会可以根据公司盈利及经营情况提议公司进行中期利润分配。

4、利润分配的具体条件。（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

5、利润分配方案的决策机制和程序。

公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事应当对董事会拟定的利润分配方案进行审核并独立发表明确意见。

监事会应对董事会制定公司利润分配方案的过程及决策程序进行监督并发表审核意见。

董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；董事会审议通过利润分配方案后公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的意见。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

6、调整利润分配政策的决策程序。（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，应当满足公司章程规定的条件，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定；（2）公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。（3）公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

7、公司在决定子公司各年度利润分配方案时，应确保母公司能有效执行现金分红比例的规定。在子公司符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况下，公司将通过行使股东权利促使子公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之三十，且所分配金额应保证母公司有能力每年以现金形式分配的利润不少于合并口径当年实现的可分配利润的百分之二十。具体分配方案由子公司股东决定。

8、公司未分配利润的使用原则：公司留存的未分配利润将主要用于投资或日常运营，以满足生产经营或优化财务结构需要，以促进公司可持续发展。

9、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

10、信息披露。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”

二、公司最近三年利润分配情况

（一）2021 年年度利润分配方案及执行情况

2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，并于 2022 年 6 月 8 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，以实施利润分配方案时股权登记日的总股本 194,049,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），共计派发现金股利 8,732,240.01 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，不送红股。

（二）2022 年年度利润分配方案及执行情况

2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，并于 2023 年 5 月 29 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以实施利润分配方案时股权登记日的总股本 213,454,755 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 10,672,737.75 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，不送红股。

（三）2023 年年度利润分配方案及执行情况

2024 年 4 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，并于 2024 年 5 月 8 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以实施利润分配方案时股权登记日的总股本 246,423,916 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），共计派发现金股利 18,481,793.70 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。

（四）最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）以及《公司章程》的要求，具体如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (元, 含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率
2021 年	8,732,240.01	40,002,025.76	21.83%
2022 年	10,672,737.75	52,673,632.14	20.26%
2023 年	18,481,793.70	85,485,730.67	21.62%

三、发行人最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展,公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后,当年剩余的未分配利润结转至下一年度,主要用于公司日常的生产经营,为公司未来战略规划和可持续性发展提供资金支持。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

四、未来三年股东回报规划

为进一步规范和完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程等相关文件的规定和要求,并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素,制定了《深圳市容大感光科技股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》(以下简称“本规划”)。

(一) 制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远、可持续发展,综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势,按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

(二) 本规划的制定原则

本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下,充分重视对投资者的回报,保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论

证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（三）公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划

1、利润分配原则

公司将重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持一致性、合理性和稳定性。

2、利润分配形式

公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3、现金分红的比例

（1）在符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况下，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于合并口径当年实现的可分配利润的百分之二十。如果公司当年现金分红的利润已超过合并口径当年实现的可分配利润的百分之二十或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过合并口径当年实现的可分配利润的百分之二十，对于超过部分公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（2）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

④公司发展阶段不易区分的，由董事会审议确定发展阶段。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，且超过 5,000 万元。

4、利润分配的时间间隔

公司原则上每年进行一次年度利润分配，董事会可以根据公司盈利及经营情况提议公司进行中期利润分配。

5、利润分配的具体条件

- (1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
- (2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(四) 利润分配政策的决策机制和程序

公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事应当对董事会拟定的利润分配方案进行审核并独立发表明确意见。

监事会应对董事会制定公司利润分配方案的过程及决策程序进行监督并发表审核意见。

董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；董事会审议通过利润分配方案后公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的意见。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

（五）利润分配政策的调整机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，应当满足公司章程规定的条件，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定。

2、公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。

3、公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

（六）信息披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（七）其他事宜

1、当股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。

4、本规划由公司董事会负责解释。

第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外，公司未来十二个月内暂未确定其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

二、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

（一）本次发行对公司主要财务指标的影响分析

1、主要假设和前提条件

以下假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不代表公司对 2024 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。

公司对 2024 年度主要财务指标的测算基于如下假设：

（1）假设国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化。

(2) 假设本次发行于 2024 年 8 月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准。

(3) 在预测公司总股本时，以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 246,423,916 股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股票股利、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响。

(4) 假设本次发行数量 2,400.00 万股，该数量仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准。

(5) 假设本次募集资金总额 24,500.00 万元，且不考虑相关发行费用，本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

(6) 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 8,548.57 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,915.11 万元。假设 2024 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：①较 2023 年度持平；②较 2023 年度同比增长 20%；③较 2023 年度同比减少 20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

(7) 不考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

(8) 不考虑公司未来现金分红的影响。

(9) 假设在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司未来资本公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的因素。

2、对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况

如下表：

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	24,642.39	24,642.39	27,042.39
本次发行募集资金总额（万元）			24,500.00
本次向特定对象发行股份数量（万股）			2,400.00
预计本次发行完成月份			2024 年 8 月
项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	
		本次发行前	本次发行后
假设情形一：2024 年扣非前后归母净利润持平			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,548.57	8,548.57	8,548.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	7,915.11	7,915.11	7,915.11
基本每股收益（元/股）	0.36	0.35	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.35	0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	0.31
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32	0.31
假设情形二：2024 年扣非前后归母净利润均同比增长 20%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,548.57	10,258.29	10,258.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	7,915.11	9,498.13	9,498.13
基本每股收益（元/股）	0.36	0.42	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.42	0.40
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.33	0.39	0.37
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.33	0.39	0.37
假设情形三：2024 年扣非前后归母净利润均同比减少 20%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,548.57	6,838.86	6,838.86

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	7,915.11	6,332.09	6,332.09
基本每股收益（元/股）	0.36	0.28	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.28	0.27
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.33	0.26	0.25
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.33	0.26	0.25

注：上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定进行计算。

（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，由于募集资金投资项目产生的经济效益需逐步释放。虽然公司将合理有效使用本次发行所募集资金，但是募投项目产生效益需要一定的时间。因此，本次发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率较上年出现下降的情形，即本次发行募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。

同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2024 年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

（三）本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性参见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司的主营业务为 PCB 光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等感光电子化学品的研发、生产和销售，主要产品为 PCB 感光油墨、PCB 感光干膜、特种油墨、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列感光电子化学品。公司本次发行募集资金围绕主营业务展开，其中高端感光线路干膜光刻胶建设项目是公司顺应产业发展趋势、响应下游客户需求、优化公司产品结构做出的重要布局，符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于进一步提升公司盈利能力，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目将助力公司布局相关领域，提升产品研发设计效率，加速高端 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶产品国产化突破。补充流动资金可以为公司未来业务发展提供资金保障，优化公司资本结构，降低财务风险。

2、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次发行的募集资金投资项目已经过详细的分析论证。公司在人员、技术、市场等方面均进行了充分的准备，公司具备募集资金投资项目的综合执行能力，具体参见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二/（一）/3、项目实施的可行性”。

（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

考虑到本次向特定对象发行股票对普通股股东即期回报摊薄的影响，为保护投资者利益，填补本次向特定对象发行股票可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力，具体如下：

1、合理统筹资金，积极提升公司盈利能力

本次发行募集资金到位后，公司将继续提高内部运营管理水平，持续优化业务流程和内部控制制度，降低公司运营成本，提升公司资产运营效率。同时，将加快募集资金投资项目建设的推进，力争早日实现预期收益，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。此外，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激

励机制，激发全体公司员工的工作积极性和创造力。通过上述举措，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营效益。

2、加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，规范募集资金使用，保证募集资金充分有效利用。公司董事会将持续对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

3、加强经营管理和内部控制，为公司发展提供制度保障

公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能；推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。同时，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供坚实的制度保障。

4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将严格执行利润分配规定，重视投资者回报，降低本次发行对公司及其回报的摊薄，切实保障投资者合法权益。

未来经营结果受多种宏微观因素影响，存在不确定性，公司制定填补回报措

施不等于对公司未来利润做出保证。

(六)公司相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、控股股东、实际控制人出具的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

2、公司董事、高级管理人员出具的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、承诺本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。

8、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

（本页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》之签章页）

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日